

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	华泰资管 Oberweis Goldennest Capital 华泰证券
时间	2024年3月5日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监兼董事会秘书：周小东 证券事务代表：周鸳鸯
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司 2023 年整体经营情况</p> <p>公司 2024 年 1 月 25 日发布 2023 年度业绩预告，预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 13,000 万元至 16,500 万元，同比下降 70.09%至 62.04%。主要是受宏观经济环境、行业库存水平持续高位等因素影响，2023 年 PCB 行业整体需求低迷，下游客户资本支出明显减少，部分扩产项目出现延迟或取消的情况，对公司设备订单产生较大影响，导致公司营业收入和利润较上年同期有所下滑。</p> <p>二、公司核心竞争优势</p> <p>PCB 板种类繁多，生产制造流程较长，各工序环节的技术原理及加工要求差异较大，行业内专用设备企业一般只聚焦于某单一或</p>

少数工序的技术。与行业内大部分企业有所区别，公司凭借对高速高精运动控制、精密机械、电气工程、软件算法、先进光学系统、激光技术、图像处理、电子测试等先进技术的综合运用，先后拓展了钻孔、曝光、成型、检测等多个 PCB 关键工序及多层板、HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个 PCB 细分市场。

公司通过布局 PCB 生产中关键工序及多品类产品为客户提供一站式解决方案，形成了技术、产品、应用场景、供应链、客户多维协同的创新业务发展模式，同时，针对不同应用场景的技术特点进行工艺创新，深入挖掘不同细分市场的价值潜力，对市场价值量大、成长快速的应用场景优先布局，更好地满足不断演进的 PCB 先进制造需求，为客户提供具有市场竞争力的智能制造解决方案。

三、多层板市场业务拓展情况

普通多层板市场降本增效持续推进，自动化设备需求增长明显。公司推出的自动上下料机械钻孔机、自动插拔销钉机械成型机、自动外观检查机（AVI）、自动分拣包装机等自动化设备，大幅提升了下游 PCB 企业的产线稼动率并降低人力的投入，为 PCB 企业降本增效提供支撑，进一步提升公司市场地位。

而在高多层板市场方面，公司推出的 CCD 六轴独立机械钻孔机、高对位精度激光直接成像机、大台面通用测试机及四线测试机等设备可满足通信设备、服务器、AI 加速器等应用领域高速产品的信号完整性对加工设备的高精度要求。

四、HDI 板市场及 IC 封装基板领域产品进展

5G 智能手机、汽车自动驾驶等终端的普及和发展对 HDI（高密度互联）板的加工提出了更高的技术要求，从而拉动了 CO₂ 激光钻孔机、UV+CO₂ 复合激光钻孔机、高解析度激光直接成像机、高精测试机等设备需求的增长。公司将 HDI 板市场细分为不同终端应用场景，针对不同需求提供对应的解决方案。伴随国内电子终端品牌供应链国产化率提升的需求，将带动公司在 HDI 板市场份额的提升。

在 IC 封装基板市场，公司多类产品取得突破，部分产品进入高阶 FC-BGA 封装基板加工领域。公司研发的高转速机械钻孔机、高精测试机产品获得国内多家龙头客户的认证并形成正式销售；运用新型激光技术开发出的用于高阶封装基板超高叠层、内埋高精度

	元器件等高阶封装基板工艺的产品方案，获得了国际芯片厂商的技术认证；最新研发的±2.5μm 综合对位精度的高精专用测试设备，综合性能已能够对标全球封装基板测试设备龙头企业 Nidec-Read 的主流机型，相关产品市场份额有望实现提升。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 5 日